

【景美科技 2026 年 8 月營收新聞稿】

景美科技 (7899) 8 月營收 83,653 仟元 衝上歷史新高 年增 114%

前八月營收已達去年全年 1.27 倍 細微鑽孔雙引擎全速運轉

2026 年 9 月 9 日 / 新北市

先進製程測試介面結構件供應商 景美科技 (7899) 今 (9) 日公告，2026 年 8 月合併營收達新台幣 83,653 仟元，較去年同期成長 113.74%，一舉突破 6 月所創的 80,511 仟元，改寫公司成立以來單月營收最高紀錄；累計 2026 年前 8 月合併營收 545,665 仟元，年增 87.30%，僅以八個月即達 2025 年全年營收 428,592 仟元的 1.27 倍，超出去年全年 117,073 仟元。

■ 8 月一舉寫下三項紀錄：歷史新高、連八個月同期新高、月增 16.56%

8 月營收 83,653 仟元，同時締造三項紀錄：一、超越 6 月 80,511 仟元，成為公司歷史單月營收新高；二、自 2026 年 1 月起，連續八個月每月營收均改寫歷年同期最高紀錄；三、較 7 月 71,766 仟元再成長 16.56%，於高基期之上續創新高，並非單月急拉，而是逐月墊高的節奏延續。

■ 第三季開局兩個月 已超越去年第三季整季營收 44%

7 月與 8 月合計營收 155,419 仟元，已較 2025 年第三季全季 107,845 仟元高出 44.11%；亦即第三季尚有一個月未計入，營收規模已明顯跨越去年同季整季水準。相較今年第二季 210,817 仟元，前兩個月即已達成 73.72%，第三季延續逐季成長的態勢已見明確輪廓。

■ 細微鑽孔雙引擎全速運轉 探針卡導板與測試座同步放量

景美科技 品牌 總經理 鄭雅文 表示，8 月營收再創新高，最主要的推力來自探針卡導板細微鑽孔產品線，且動能同時來自兩個方向：

其一，台系探針卡大廠客戶細微鑽孔訂單持續放量。隨 AI 與 HPC 晶片測試需求擴大，該客戶高針數探針卡專案陸續進入量產，帶動導板細微鑽孔出貨連月走高。由於細微鑽孔以孔數計價，孔位數越多、孔距越密，單片加工價值越高，在針數提升的趨勢下，出貨量與單價形成同向推升的效果。

其二，後段測試客戶測試座 (Test Socket) 細微鑽孔營收持續貢獻。後段測試客戶測試座細微鑽孔出貨持續放量，已成為穩定的營收來源，讓公司的細微鑽孔能力由晶圓測試探針卡導板延伸至後段測試的測試座，客戶基礎與應用場景同步擴大，降低對單一客戶或單一測試環節的依賴。

鄭雅文進一步指出，細微鑽孔為公司技術門檻最高的產品線，占營收比重已由上半年的 26% 提升至 1~8 月的 31%，在雙客戶引擎同步放量下，比重持續墊高，對整體毛利結構亦具正向作用。

■ 下半年既有專案陸續量產 以逐季成長為營運目標

景美科技業務協理 張鎂崢 表示，公司今年營收表現，是客戶結構、產品組合與製程能力三方面同步到位的結果。除細微鑽孔雙引擎外，全球最大晶圓代工廠訂單維持穩定，日系測試機框 (ATE Stiffener) 自第一季起穩定出貨，探針卡結構組件亦隨客戶專案量產同步成長。展望下半年，既有客戶專案陸續進入量產階段，公司將持續以延續逐季成長態勢為營運目標，並聚焦高精度製程能力升級與高毛利產品比重提升，以技術領先、品質穩定與量產交付三大核心優勢，朝向全球先進製程測試介面關鍵結構件供應商目標穩健邁進。

景美科技自結營收簡表 (公開資訊觀測站公告營收)：單位：新台幣千元；%

年度/月份	2026 年	2025 年	增減百分比
8 月	83,653	39,138	YoY +113.74%
7~8 月 (第三季迄今)	155,419	72,965	YoY +113.00%
1~8 月	545,665	291,328	YoY +87.30%

註：2025 年第三季 (7~9 月) 合併營收 107,845 千元；2025 年全年合併營收 428,592 千元。

新聞發言人：品牌 總經理 鄭雅文 winwin_cheng@cmat-tek.com.tw 0933-888-334

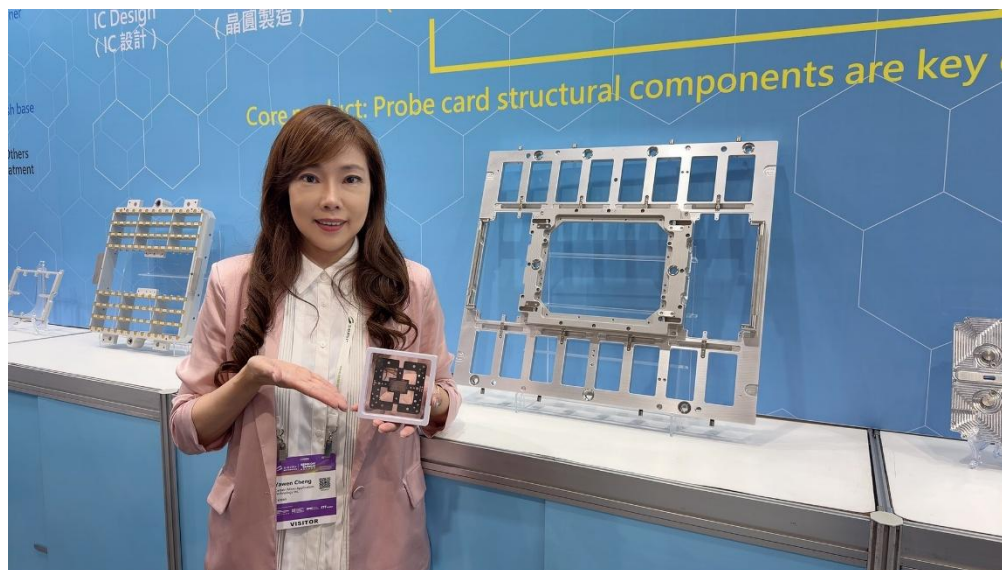
公司簡介：

半導體先進製程測試介面 關鍵結構件供應商 景美科技股份有限公司 (7899.TW) 於 2026 年 2 月 25 日正式登錄興櫃交易。公司成立於 2006 年，專注於半導體先進製程探針卡細微鑽孔與結構件之設計、製造與銷售，實收資本額約新台幣 2.29 億元。景美科技深耕探針卡結構件近 20 年，客戶涵蓋全球最大晶圓代工廠、歐美日韓探針卡廠及台灣前三大探針卡廠，產品包含晶圓測試(CP)用垂直式探針卡 (VPC) 與微機電探針卡 (MEMS) 之關鍵結構件，核心產品涵蓋上下導板細微鑽孔 (Upper Plate / Lower Plate)、ATE Stiffener、Spacer、JIG、Backer 等高精度、高門檻關鍵結構件，為高階晶片測試不可或缺的重要組成。

景美科技之競爭優勢包括：1.具備完整之探針卡結構件設計與開發能力。2.兼具高強度合金金屬材料、高性能工程塑膠與複合材料之整合實力。3.以高精度組裝工藝有效控制公差累積，確保模組功能性與高度可靠性。4.具備少量多樣高客製化的彈性製造能力。5.以夥伴思維深度融入客戶供應鏈，建立互補協作模式並加速產品認證。



全球信賴的半導體測試介面核心專家
(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)



圖說: 景美科技/ 品牌 總經理 鄭雅文 展示 先進製程使用之雷射細微鑽孔產品